



NXP stellt i.MX 93W vor: Applikationsprozessor vereint Edge-Compute und sichere Wireless-Konnektivität für Physical AI

- Erster Applikationsprozessor, der eine KI-NPU mit sicherer Tri-Radio-Konnektivität in einem einzigen Package kombiniert, wodurch bis zu 60 diskrete Komponenten ersetzt werden können.
- Die neue Lösung beschleunigt den koordinierten Einsatz von KI-Agenten durch integrierte Edge-Compute- und sichere Konnektivitätsfunktionen, unterstützt durch die NXP-Software sowie das eIQ®-AI-Enablement.
- Vorzertifizierte Designs vereinfachen die Funkzulassung, reduzieren die Komplexität im HF-Design und verkürzen die Markteinführungszeit.

Nürnberg, Deutschland, 09. März 2026 – NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXP) stellt heute den [i.MX 93W Applikationsprozessor](#) vor und erweitert damit seine i.MX 93 Familie. Dieser wurde speziell entwickelt, um die Einführung von Physical AI zu beschleunigen. Als branchenweit erster Applikationsprozessor vereint er eine dedizierte Neural Processing Unit (NPU) für KI-Anwendungen mit sicherer Tri-Radio-Funkkonnektivität in einem einzigen Package und ersetzt damit bis zu 60 diskrete Komponenten. Vorzertifizierte Referenzdesigns reduzieren den Integrationsaufwand erheblich und senken so deutlich die Komplexität, Kosten und Risiken von HF-Designs. Dank der Softwarelösungen von NXP sowie dem branchenführenden eIQ AI Enablement ermöglicht der i.MX 93W zudem kompaktere Designs und eine schnellere Markteinführung von Physical-AI-Anwendungen.

Physical AI erfordert dabei die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener KI-Agenten, die lokal und in Echtzeit mit geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit agieren. So können KI-Agenten zum Beispiel in einem smarten Gebäude Beleuchtung, HLK-Systeme, Zutrittskontrollen, Belegungsmanagement und Energiemanagementsysteme koordinieren, um Komfort, Energieeffizienz und Betriebsabläufe sicher und autonom in Echtzeit zu optimieren.

Der neue i.MX 93W ermöglicht dies durch die Integration skalierbarer Edge-Rechenfunktionalitäten, KI-Beschleunigungsfunktionen und sicherer drahtloser Konnektivität in einem einzigen Package. In Kombination mit den Softwarelösungen von NXP, eIQ AI Enablement und vorzertifizierten Referenzdesigns können koordinierte KI-Agenten physische Umgebungen lokal steuern. Ein Beispiel hierfür sind vernetzte Gesundheitslösungen, bei denen mehrere KI-Agenten Wearables, intelligente Diagnostiksysteme, Sensoren und Gesundheits-Gateways



koordinieren, um gesundheitsbezogene Erkenntnisse und Maßnahmen in Echtzeit bereitzustellen.

Zudem ermöglicht das i.MX 93W SoC es Kund:innen, Physical AI schnell auf Anwendungen wie medizinische Geräte, Smart-Building-Controller, industrielle Gateways, Energieinfrastruktur-Monitore und Smart-Home-Hubs auszuweiten.

„Mit dem i.MX 93W erweitern wir die i.MX 9 Familie, um Kund:innen dabei zu unterstützen, Physical AI schneller zu skalieren“, sagt Charles Dachs, Executive Vice President und General Manager, Secure Connected Edge bei NXP Semiconductors. „Die neue Plattform vereinfacht die Integration von KI und sicherer Wireless-Konnektivität. Zusätzlich reduziert sie die Entwicklungsaufwände und ermöglicht es Kund:innen, KI-Agenten schneller in der Edge einzusetzen.“

Robustes Ökosystem beschleunigt Entwicklung

„Das neue i.MX 93W SoC ist eine spannende Ergänzung des i.MX-Portfolios und vereint leistungsstarke Applikationsverarbeitung, integrierte KI-Beschleunigung sowie sichere drahtlose Konnektivität in einer äußerst kompakten SiP-Architektur“, sagt Andreas Kopietz, Dipl.-Ing., Sales Manager bei F&S Elektronik Systeme. „Für Embedded-Entwickler:innen vereinfacht die Kombination des i.MX 93 Applikationsprozessors mit integriertem Wi-Fi® 6, Bluetooth® LE, Thread und Zigbee das Systemdesign und die Zertifizierung erheblich. Dadurch können unsere Kund:innen den Entwicklungsaufwand reduzieren, Zertifizierungskosten senken und die Markteinführung vernetzter HMI-, Industrie- und IoT-Geräte beschleunigen.“

„Da intelligente IoT-Gateways und Edge-Geräte zunehmend skalieren, benötigen Entwickler:innen serienreife Plattformen mit leistungsfähiger Funktechnologie, hoher Sicherheit und Energieeffizienz“, ergänzt Ahmed Shameem, Associate Director of System on Modules bei iWave. „Wir bieten den i.MX 93W als vollständig integriertes System-on-Module mit Tri-Radio-Konnektivität einschließlich Wi-Fi 6 an. Das vereinfacht das Systemdesign, senkt Entwicklungsrisiken und beschleunigt die Markteinführung industrieller IoT-Lösungen der nächsten Generation.“

„Vantron ist stolz darauf, so eng mit NXP zusammenzuarbeiten und fortschrittliche eingebettete Intelligenz in der industriellen Automatisierung voranzubringen“, sagt Bo Wei, CEO von Vantron Technology. „Als hochintegrierte SiP-Plattform, die Anwendungsverarbeitung und Wi-Fi-Konnektivität kombiniert, vereinfacht der i.MX 93W das Systemdesign und reduziert den Entwicklungs- sowie Zertifizierungsaufwand. Durch diese Integration bringen unsere Kund:innen ihre Produkte schneller auf den Markt, senken die Systemkosten und entwickeln robuste



sowie sichere Lösungen für anspruchsvolle Produktionsumgebungen mit langfristiger Betriebssicherheit.“

Integrierte skalierbare Rechenleistung und sichere Konnektivität für Physical AI

Der [i.MX 93W Applikationsprozessor](#) kombiniert eine dedizierte NPU für KI-Anwendungen mit sicherer Tri-Radio-Konnektivität in einem einzigen Package. Dadurch entfallen bis zu 60 diskrete Komponenten, was die Leiterplattenfläche, die Design- und Lieferkettenkomplexität sowie die Systemkosten deutlich reduziert. Der i.MX 93W verfügt über einen Dual-Core Arm® Cortex® A55 Applikationsprozessor mit einer dedizierten Arm Ethos NPU, die bis zu 1,8 [eTOPS](#) erreicht. Das integrierte [IW610-Tri-Radio](#) vereint Wi-Fi® 6, Bluetooth® Low Energy sowie 802.15.4-Konnektivität und unterstützt Implementierungen von [Matter](#) und Thread. Dadurch entfallen aufwendige HF-Abstimmungen und Koexistenzprobleme, die Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse bislang verzögern, wodurch die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt werden kann.

Sicherheit nach dem Security-by-Design-Prinzip mit EdgeLock Secure Enclave

Das i.MX 93W-SoC integriert eine [EdgeLock Secure Enclave \(Advanced Profile\)](#) und adressiert regulatorische Anforderungen, einschließlich des [europäischen Cyber Resilience Act \(CRA\)](#). Die integrierte EdgeLock Secure Enclave bildet die Hardware-Root-of-Trust und erleichtert die Umsetzung sicherheitskritischer Funktionen wie Secure Boot (sicherer Systemstart), Secure Update, Geräteattestierung und sicheren Gerätezugriff. In Kombination mit den [EdgeLock 2GO Schlüsselmanagement-Services von NXP](#) können OEMs i.MX 93W-basierte Produkte sowohl während der Fertigung als auch im Einsatz sicher mit kryptografischen Schlüsseln und Zertifikaten ausstatten.

Vorzertifizierte Referenzdesigns beschleunigen die Markteinführung

Die vorzertifizierten Single- und Dual-Antennen-Referenzdesigns von NXP auf Basis des i.MX 93W minimieren den HF-Abstimmungsaufwand und beseitigen zahlreiche typische Integrationsherausforderungen. Die in mehreren Ländern und Regionen zertifizierten Designs reduzieren die Komplexität, Kosten und Risiken, die üblicherweise mit HF-Design und Funkzulassung verbunden sind. Dank validierter Antennenoptionen und bereits zertifizierter Designs lassen sich Zulassungsprozesse verkürzen, Entwicklungskosten senken und somit Produkte schneller auf den Markt bringen.

Verfügbarkeit

Der i.MX 93W wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 als Muster verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter [NXP.com/imx93w](https://www.nxp.com/imx93w).



Über NXP Semiconductors

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) ist der verlässliche Partner für innovative Lösungen in den Bereichen Automotive, Industrie & IoT, Mobilfunk und Kommunikationsinfrastruktur. Der „Brighter Together“-Ansatz von NXP bringt Spitzentechnologie mit Menschen voller Pioniergeist zusammen, um Systemlösungen zu entwickeln, welche die vernetzte Welt besser, sicherer und zuverlässiger machen. NXP ist in über 30 Ländern vertreten und verzeichnete 2025 einen Umsatz von 12,27 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.nxp.com.

EdgeLock, NXP und das NXP-Logo sind eingetragene Marken von NXP B.V. Alle anderen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten. © 2026 NXP B.V.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

NXP Americas & Europe

Phoebe Francis

Tel: +1 737 274 8177

Email: phoebe.francis@nxp.com

NXP Greater China / Asia

Ming Yue

Tel: +86 21 2205 2690

Email: ming.yue@nxp.com